

<b>Стандартизация производства</b>		Nadcap, AS9100C, IPC Class 2, 3 and Class 3A, ISO 14001, MLA - ITAR & EAR registered, MIL-PRF-55110G, UL Certified	
<b>Форматы документации</b>	Формат файлов топологии	DXF, RS-274-X, RS-274-D, ODB++, CAD, CAM	
	Формат файлов мех. обработки	ASCII, EXCELLON Format: RS-274-X, RS-274-D	
	Формат электрических цепей	IPC-D356	
	Формат файлов для электроконтроля	IPC-D356, IPC-D356A	
	Архивы	ZIP, TAR, TGZ, RAR	
	Программные инструменты	Genflex, Inplan, Exact, Insight, Polar, SAP, CAM350	
<b>Сфера применения</b>		Военная Аэрокосмическая	Медицинская Промышленная
<b>Виды печатных плат</b>	Жесткие (ОПП, ДПП, МПП)	От 1 до 60 слоев	
	Гибко-жесткие ПП	До 20 слоев	
	Гибкие ПП	До 10 слоев	
	На металлическом и керамическом основании	1-2 слоя	
	СВЧ платы Rogers, Arlon и пр.	До 30 слоев	
	Гибридная конструкция Rogers+FR4	До 30 слоев	
<b>Размер производственной панели</b>		Min 12"x18" (305x457мм)   Max 24"*32"(610x813мм)	
		Технологические поля: 1.5" со всех сторон	
		Максимальная толщина платы - 0.320"(8,1 мм)	
		Минимальная толщина платы - 0.002" (0,05 мм)	
<b>Материалы</b> *доступны под заказ **доступны по запросу	FR-4	ITEQ IT-180A and ISOLA-370HR	No Flow PP(PI) : Ventec - VT-901 NF and ARLON/38N
		Isola FR 406	NF FR4 : ARLON, 51N, VENTEC VT-47 , ISOLA FR406(N).
		Isola 185HR*	Nelco BT N5000*
		Isola IS410 (CAF Resistant)*	Nelco 4000-29*
		Isola IS415 (CAF Resistant)*	Nelco 4000-13 and 13SI*
		Isola FR408 and FR408HR and FR408HRSI	Nelco 4000-13EP and EPSI*
		Isola I-Tera MT*	Polyimide: 35N/ VT901/NELCO7000
		Isola BT IS620	Teflon Brass
	СВЧ Материалы	Rogers 3000 Series*	TMM*
		Rogers 4000 Series	Hitachi Materials*
		Rogers 5000 Series	FARADFLEX/ OAK-Mitsui
		Rogers 6000 Series	(Embedded Capacitance Material)*
		Taconic RF materials* (Including FR25.FR26,FR27 etc)	ROHACELL*
		Isola Astra MT*	Rogers 2929 Bond ply*
		Nelco 9000 Series*	Arlon 6700
		Arlon Materials*	6250 Bond ply*
	Гибкие Материалы	Panasonic Megtron 6, 7*	Ticer - Buried resistors
		Dupont - AP series, LF series Panasonic -FELIOS, All series	Hitachi Materials*

<b>Травление</b>	Внутренний слой: минимальный проводник/зазор	Толщина меди 0,5oz (18 мкм)	0.002" (0,05 мм)/0.0025" (0,063 мм)	
		Толщина меди 1oz (35 мкм)	0.0035" (0,089 мм)/0.004" (0,1 мм)	
		Толщина меди 2oz (70 мкм)	0.005" (0,125 мм)/0.006" (0,15 мм)	
		Толщина меди 3oz (105 мкм)	0.009" (0,22 мм)/0.011" (0,28 мм)	
		Толщина меди 4oz (140 мкм)	0.012" (0,3 мм)/0.016" (0,4 мм)	
	Внешний слой: минимальный проводник/зазор	Толщина меди 1oz (35 мкм)	0.00275" (0,069 мм)/0.0035" (0,089 мм)	
		Толщина меди 1.5oz (50 мкм)	0.0035" (0,089 мм)/0.004" (0,1 мм)	
		Толщина меди 2oz (70 мкм)	0.004" (0,1 мм)/0.005" (0,125 мм)	
		Толщина меди 3oz (105 мкм)	0.006" (0,15 мм) /0.008" (0,2 мм)	
		Толщина меди 4oz (140 мкм)	0.009" (0,22 мм)/0.012" (0,3 мм)	
<b>Гарантийный поясок</b>	Минимальный гарантийный поясок на монтажных отверстиях	IPC-600 Class 3		
	Минимальный	IPC-600 Class 3		
	Минимальный гарантийный поясок лазерного отверстия	0,15 (0,125) мм		
<b>Механические возможности</b>	Возможности сверловки	Минимальный диаметр	0.006" (0,15 мм)	
		Минимальное расстояние от механического отверстия до проводника	0.006" (0,15 мм)	
		Допуск на неметаллизированные отверстия	0.001" (0,05 мм)	
		Минимальный допуск на металлизированные отверстия	0.003" (0,075 мм)	
		Минимальное расстояние от неметаллизированного отверстия до края платы	0.010" (0,25 мм)	
		Минимальный допуск на отверстий под запрессовку	0.001" (0,05 мм)	
		Отношение диаметра отверстия к глубине отверстия при котором возможна металлизация	1:1	
	HDI / Лазерные / Микроотверстия	Минимальный диаметр лазерного	2.5 mil (0,063 мм)	
		Минимальное расстояние от лазерного отверстия до проводника	0.004" (0,1 мм)	
		Отношение диаметра отверстия к глубине отверстия при котором возможна металлизация для микроотверстий	1:1	
		Stacked Via Заполнение медью микроотверстий		
	Фрезеровка на глубину	Допуск сверления на глубину	0.005" (0,125 мм), 0.004" (0,1 мм)	
		Удаление металлизированного ствола отверстия высверливанием		
	Глухие и слепые отверстия	Минимальный зазор между сверлом для высверливания и проводником	0.006" (0,15 мм)	
		Минимальное финишное отверстие	0.008" (0,2 мм)	
		Максимальное финишное отверстие для заполнения смолой	0.025" (0,63 мм)	
	Краевой разъем	Отношение диаметра отверстия к глубине отверстия при котором возможно заполнение смолой	10:1	
		Угол фаски	15°, 20°, 30°, 45°	
	Возможности фрезерования	Допуск на глубину	+/-0.005" (0,125 мм)	
		Допуск на фрезерование	+/-0.005" (0,125 мм), +/-	
		Минимальный диаметр фрезы	0.015"	

	Отверстия на контактных площадках	Минимальное финишное отверстие	0.004''(0,1 мм)
		Максимальное финишное отверстие для заполнения смолой	0.020''(0,5 мм)
		Минимальная толщина платы для отверстий на КП	0.012''(0,3 мм)
		Максимальная толщина платы для отверстий на КП	0.236''(6 мм)
Паяльная маска	Минимальный отступ	0.0015'' (0,038 мм)	
	Минимальный масочный	0.004''(0,1 мм)	
	Цвет маски	Зеленый, синий, красный, черный, белый, матовый зеленый и	
Маркировка	Минимальная толщина линии	0.005''(0,125 мм)	
	Цвет маркировки	Белый, черный, желтый	
Финишные покрытия		HAL-Hot Air Level (Leaded)	Full Body Gold
		Immersion Silver	Hard Gold - Electrolytic
		OSP	Hard Gold (over Ni) - Electrolytic
		ENIG	Nickel - Electrolytic
		ENEPIG	Soft Gold (Bondable Gold) Electrolytic
		ISIG	Electrolytic Matt Tin
		Immersion Tin	
Комбинированные покрытия		HASL with Selective Gold (ENIG or Hard/ Soft Ni-Gold).	Immersion Gold w/ Selective Hard Gold on Fingers
		Dual Gold Plating	Recessed Fingers
Тесты	Электротестирование	Flying Probe	
	Контроль импеданса	+/-10% (+/-5%)	
Специальные возможности		Металлизация торцов	ROHACELL Foam Bonding
		Заполнение переходных отверстий смолой	Встроенные компоненты (Интегрирование пассивных и активных элементов)
		Заполнение переходных отверстий маской	Воздушные полости/Air Cavity (RF/Microwave application)
		Полуотверстия	Полости/Cavities
		UL сертификация	Coin Technology (Heat dissipation)
		ISO сертификация	RF single side up-to 3 meters
		Жесткая медь /Heavy Copper (до 20oz)	RF single side up-to 3 meters
		Охладители/Heatsinks	Hybrid Boards
		Back-Planes	Book-Binder